



2007年3月期 決算説明会

2007年5月18日

ワイエishi株式会社



次 第

1. ご挨拶と会社概要・・・・・・・・・・・・ 代表取締役社長
百瀬 武文

2. 決算の概要と2008年3月期・・・・ 執行役員人事総務部長
の業績予想 宮本 忠泰

3. 第9次中期計画と基本戦略・・・・ 代表取締役社長
・ (07年3月期～09年3月期)の概要 百瀬 武文
・ FEL新規事業について

4. 質疑応答



本日のキーメッセージ

- 5年連続最高益(最終利益)をめざす
- 高収益企業への定着(企業文化)に向けあくなき挑戦
- 新規事業に果敢にチャレンジ



1. 会社概要



1-1 基本情報

(2007年4月20日現在)

商号	ワイエイシイ株式会社
証券コード	6298 (東証2部)
設立	1973年(昭和48年)年5月
代表者	代表取締役社長 百瀬武文
事業所等	本社：東京都昭島市武蔵野3-11-10 営業所：大阪、福岡、大分、昭島 工場：昭島、山梨、熊本
子会社	ワイエイシイ新潟精機株式会社 (新潟県妙高市) HYAC Corporation (米国) YAC Systems Singapore Pte Ltd (シンガポール)
資本金	2,756百万円
事業内容	産業用エレクトロニクス関連装置、クリーニング関連装置の開発・製造・販売
決算	3月31日



1-2 当社の主力製品

ハードデスク関連

- ・バニッシャー装置
- ・ワイピング装置
- ・クリーンコンベア

液晶関連

- ・プラズマ・ドライ・エッチング装置
- ・プラズマ・ドライ・アッシング装置

半導体関連

- ・ロジック系IC用テストハンドラー

クリーニング関連

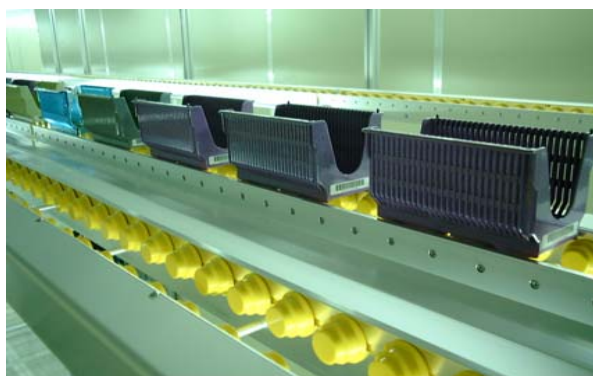
- ・自動包装機
- ・ワイシャツ仕上機

<ハードディスク関連製品>

バニッシャー	ハードディスク製造工程において、ディスクに磁性体を生成後、表面のナノオーダーの微小突起を除去する精密研磨装置
ワイピング	ハードディスク製造工程において、ディスクに磁性体を生成後、バニッシュ工程の前後で、表面のパーティクルの除去及び潤滑財を表面に均一にする装置
クリーンコンベア (HD工場向け)	モジュールの組み合わせで自由な搬送ライン設計が可能なローラー式コンベアAGV(自走型搬送ロボット)やOHT(天井架設型搬送装置)に比べ、搬送物をいつでも搬送ラインに投入することができ、搬送効率が高い。
クリーンコンベア (半導体工場向け)	(同上)但し、搬送物が300mm用ウエハカセットのため、ハードディスク用に比べコンベア幅大きく、より高い耐加重性、高速搬送が要求される。



バニッシャー



ハードディスク用クリーンコンベア

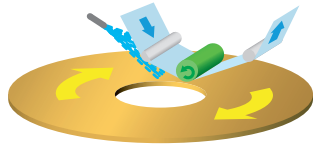


半導体用クリーンコンベア

当社主力製品の利用工程

ハードディスク「メディア工程」

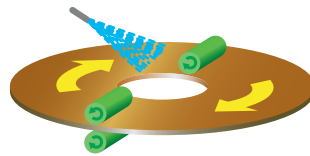
テクスチャー工程



基板に下地層形成後磁性膜の特性を良くするために研磨液と研磨テープを用いて表面を研磨します。

当社製品 テクスチャー装置
テクスチャー用テープ

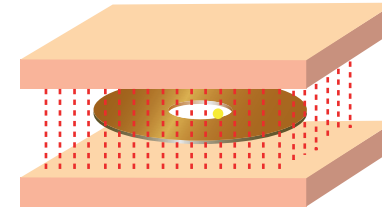
洗浄工程



洗浄液で表面を洗浄します。

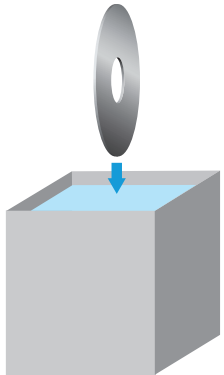
当社製品 移載機
クリーンコンベア

スパッタリング工程



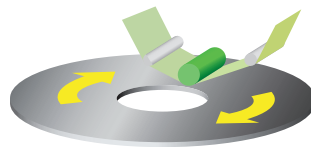
表面に磁性膜・保護膜を生成します。

ルブ・ベイク工程



表面に潤滑剤を塗布します。

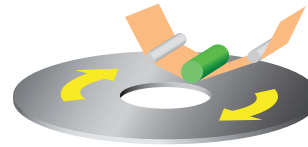
バニッシュ工程



研磨テープを用いて表面の突起を除去します。

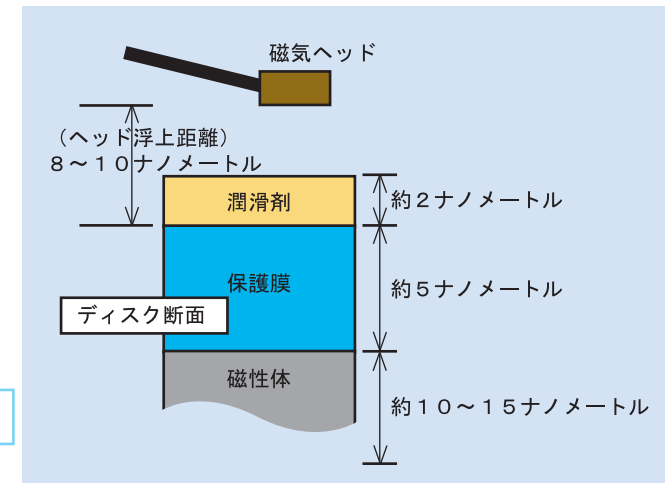
当社製品 バニッシャー
バニッシング用テープ

ワイピング工程



クリーニングテープを用いて表面をクリーニングします。

当社製品 ワイピングテープ



<液晶関連製品>

プラズマ・ドライ・エッチング
装置

液晶ディスプレイの各セルの液晶整列方向を個々に制御する微小トランジスターをガラス基板上に描画するプロセスで用いる。
フォトマスクを通して露光した結果、硬化した部分以外を除去後、露出した薄膜をプラズマを利用してガス化し除去する装置。



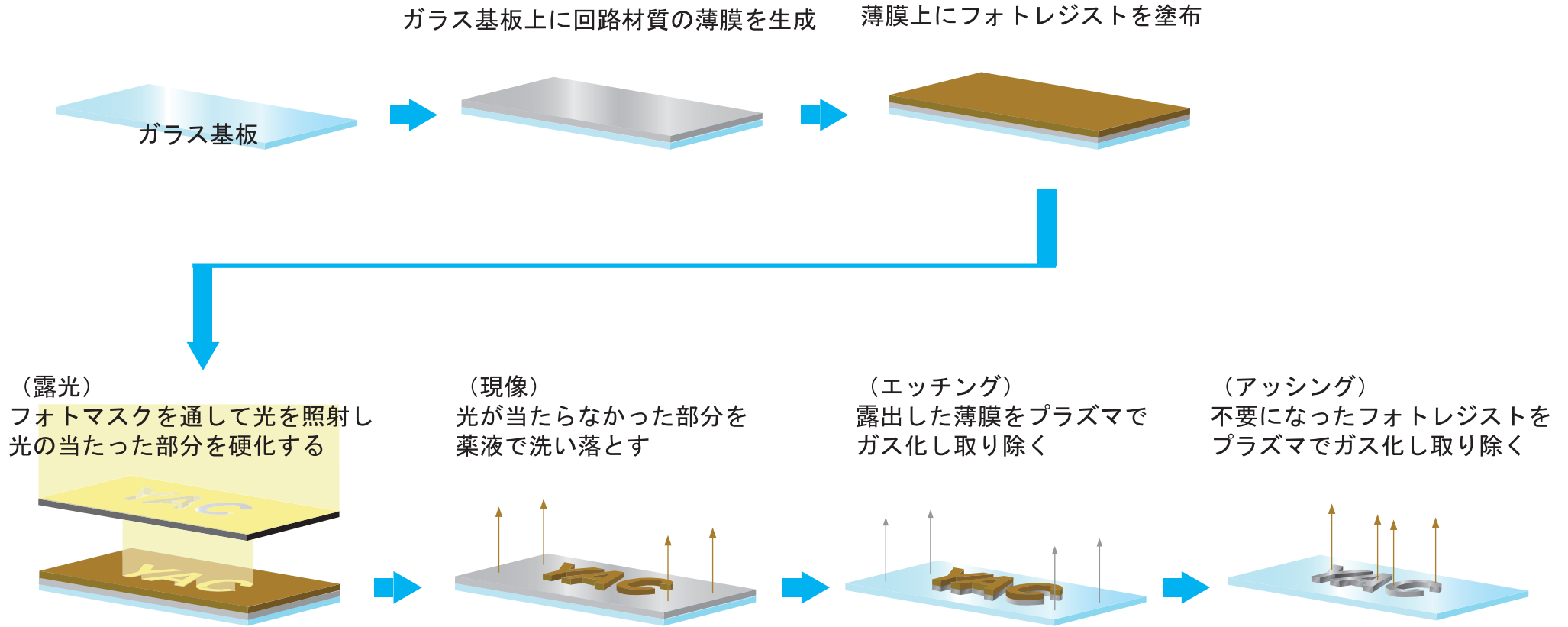
第7世代用プラズマ・ドライ・エッチング装置(3チャンバータイプ)

対応
基板サイズ

G2
G4
G4.5
G5
G5.5
G6
G7
G7.5
G8

当社主力製品の利用工程

液晶パネル製造「アレイ工程」



当社製品 プラズマ・ドライ・エッチング装置

当社製品 プラズマ・ドライ・アッシング装置

※上記の工程を何度か繰り返し、回路が完成します。

<半導体関連製品>

ロジック系IC用
ICテストハンドラー

ICのパッケージング後の検査工程で、テスターと接続して使用し、テスターからのテスト結果信号に基づき、ICを良品と不良品に自動選別する装置。
必要に応じて、精度の高い高温・低温(-55°C~155°C)下でのテストも行う。



ICテストハンドラー(4個同時測定・常温タイプ)

<クリーニング関連製品>

ボディープレス機	シャツを前後から熱版ではさみシャツのボディー部をプレスする装置。 胴立を2つもち、プレス中に次のシャツを装填できるダブルタイプと、胴立がひとつのシングルタイプがある。 またプレス完了のシャツを自動でハンガーの掛けるオートキャリー付のタイプもあり。
タック・スリーブプレス機	シャツのタック部・袖部のプレス機(ダブルタイプ・シングルタイプ)
カラー・カフスプレス機	シャツの襟部・カフス部のプレス機(ダブルタイプ・シングルタイプ)
包装機	クリーニング完了後の衣類にカバーフィルムを自動で装填する装置。 ハンガーのままカバーする立体タイプとたたんだ状態でカバーする平面タイプがある。



シャツ用ボディープレス機
(Wタイプ・オートキャリー付)



包装機 (立体タイプ)



2. 決算の概要と 2008年3月期の業績予想



2-1 決算のハイライト(連結)

単位 百万円

科目	2005年 3月期	2006年 3月期	2007年 3月	対前年 増減額	対前年比 増減率(%)
売上高	18,711	18,050	22,423	4,373	24.2%
営業利益	1,545	2,495	3,676	1,181	47.3%
経常利益	1,508	2,401	3,583	1,182	49.2%
当期利益	1,197	1,504	2,103	599	39.8%
1株当たり当期利益	139.4	167.8	219.1	51.3	30.6%
営業利益率	8.3%	13.8%	16.4%		

- **売上高:** 全事業で拡大、特にハードデスク関連が大きい
- **営業利益:** 継続的に取り組んでいる高収益企業への仕組により大幅に改善
(オンリーワン技術、依命書システム、低コスト経営、
モチベーションの高揚)



2-2 事業別売上金額(連結)

単位 百万円

科目	2005年 3月期	2006年 3月期	2007年 3月期	対前年 増減額	対前年比 増減率(%)
メモリーディスク関連	4,749	6,811	9,899	3,088	45.3%
液晶関連	10,919	8,525	9,400	875	10.3%
半導体関連	1,365	1,192	1,403	211	17.7%
クリーニング関連	1,678	1,522	1,721	199	13.1%
合計	18,711	18,050	22,423	4,373	24.2%



2-3 事業別受注金額(連結)

単位 百万円

科目	2005年 3月期	2006年 3月期	2007年 3月期	対前年 増減額	対前年比 増減率(%)
メモリーディスク関連	4,689	6,650	9,612	2,962	44.5%
液晶関連	9,565	10,151	10,872	721	7.1%
半導体関連	1,610	1,146	1,368	222	19.4%
クリーニング関連	—	—	—	—	—
合計	15,865	17,946	21,852	3,905	21.7%

クリーニング関連は、販売計画に基づいた見込生産を行っておりますので除外いたします、
(受注は、注文を受けてから製作いたします)



2-4 事業部別受注残金額(連結)

単位 百万円

科目	2006年3月	2007年3月	対前年 増減額	対前年比 増減率(%)
メモリーデスク関連	3,112	2,826	▲286	▲9.1%
液晶関連	8,406	9,879	1,473	17.5%
半導体関連	193	158	▲35	▲18.1%
クリーニング関連	—	—	—	—
合計	11,712	12,862	1,152	9.8%



2-5 損益計算書のレビュー(連結)

単位 百万円

科目	2005年 3月期	2006年 3月期	2007年 3月期	対前年 増減額	対前年比 増減率(%)
売上高	18,711	18,050	22,423	4,373	24.2%
売上原価	15,524	13,778	16,711	2,933	21.3%
売上総利益	3,187	4,271	5,712	1,441	33.7%
販管費	1,642	1,776	2,036	260	14.7%
営業利益	1,545	2,495	3,676	1,181	47.3%
営業外収益	112	42	73	31	74.5%
営業外費用	149	136	166	30	22.1%
経常利益	1,508	2,401	3,583	1,182	49.2%
特別利益	-	6	8	2	44.5%
特別損失	129	94	117	23	25.1%
税引前当期純利益	1,378	2,313	3,474	1,161	50.2%
法人税等	180	808	1,371	563	69.7%
当期純利益	1,197	1,504	2,103	599	39.8%



2-6 貸借対照表のレビュー(連結)

単位 百万円

科目	2005年 3月期	2006年 3月期	2007年 3月期	対前年 増減額	対前年比 増減率(%)
流動資産	12,639	16,121	20,637	4,516	28.0%
現金預金	2,860	4,726	5,359	633	13.4%
売上債権	6,650	7,121	7,470	349	4.9%
棚卸資産	2,850	3,914	7,203	3,289	84.0%
その他	278	358	603	245	68.3%
固定資産	3,103	2,744	2,969	225	8.2%
有形固定資産	2,738	2,493	2660	167	6.7%
無形固定資産	17	13	109	96	686.8%
投資その他の資産	347	236	199	▲37	▲15.6%
資産合計	15,743	18,865	23,607	4742	25.1%
流動負債	9,050	8,468	12,465	3,997	47.2%
仕入債務	6,747	5,855	9,199	3,344	57.1%
短期借入金	1,569	1,041	1,363	322	31.0%
その他	736	1,571	1,903	332	21.1%
固定負債	2,080	4,189	1,098	▲3,091	▲73.8%
社債・長期借入金	1,709	3,807	609	▲3,198	▲84.0%
その他	371	381	487	106	27.8%
負債合計	11,131	12,657	13,563	906	7.2%
純資産	4,612	6,207	10,044	3,837	61.8%
負債及び資本合計	15,743	18,865	23,607	4,742	25.1%



2-7 キャッシュフロー計算書のレビュー(連結)

単位 百万円

科目	2005年 3月期	2006年 3月期	2007年 3月期	対前年 増減額
営業活動によるCF	2,541	15	2,095	2,080
投資活動によるCF	391	417	▲91	▲508
財務活動によるCF	▲2,020	1,652	▲1,400	▲3,052
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	59	6	▲53
現金及び現金同等物の増減	918	2,145	608	▲1,537
現金及び現金同等物の期末残高	2,581	4,726	5,335	609



2-8 2008年度通期計画(連結)

単位 百万円

科目	2005年 3月期	2006年 3月期	2007年 3月期	2008年 3月期 (見込)		対前年 増減額 (見込)	対前年比 増減率(%) (見込)
				(上期)	(通期)		
売上高	18,711	18,050	22,423	11,500	25,000	2,577	11.5%
営業利益	1,545	2,495	3,676	1,500	3,750	74	2.0%
経常利益	1,508	2,401	3,583	1,450	3,650	67	1.8%
当期純利益	1,197	1,504	2,103	850	2,200	97	4.6%
1株当たり当期純利益(円)	139.4	167.8	219.1	88.1	227.9	8.8	4.0%



2-9 事業別売上金額(連結)

単位 百万円

科目	2005年 3月期	2006年 3月期	2007年 3月期	2008年 3月期 (見込)		対前年 増減額 (見込)	対前年比 増減率(%) (見込)
				(上期)	(通期)		
メモリーディスク関連	4,749	6,811	9,899	4,500	10,500	601	6.1%
液晶関連	10,919	8,525	9,400	5,500	10,600	1,200	12.8%
半導体関連	1,365	1,192	1,403	600	1,500	97	6.9%
クリーニング関連	1,678	1,522	1,721	900	2,400	679	39.5%
売上合計	18,711	18,050	22,423	11,500	25,000	2,577	11.5%



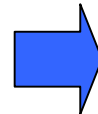
3. 第9次中期計画と基本戦略の概要



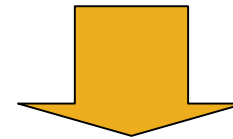
3-1 第9次中期計画の基本戦略

I T産業の特徴

1. 高成長
2. 競争激化
3. 高スピード (技術革新)
4. 市場変動 (大きい)



この事業環境における
安定的収益確保



ワイエイシイの基本戦略

1. 高収益企業への挑戦	<ul style="list-style-type: none">・オンリーワン技術の強化 (差別化)・依命システムの徹底・低コスト経営の徹底・モチベーションの一層の高揚
2. 新製品、新事業に果敢に挑戦	<ul style="list-style-type: none">・顧客との強固な信頼関係構築による市場ニーズの先取り・顧客から見た差別化の徹底 (特許)・スピード対応・マーケットリーダー、プライスリーダー、ブランドの向上
3. ファブレス経営の徹底 (産業用エレクトロニクス部門)	<ul style="list-style-type: none">・営業、開発、技術、アフターサービスを中心とした経営体制・市場変動による経営リスクの最小化



3-2 第9次中期計画の基本戦略

第9次中期計画（平成18年度～20年度）

平成17年8月31日

高収益企業 への挑戦

事業予算の達成

事業部

- ・メモリーディスク
- ・半導体
- ・プラズマシステム
- ・クリーニング

グループ会社

- ・HYAC
- ・YSS
- ・YNS

(1) 事業目標

- ・守りから攻めへの転換(営業利益40億超)
- ・高収益企業への挑戦(営業利益率15%超)
- ・企業価値の向上(時価総額500億円超)
- ・企業ステータスの向上(東証一部上場)

(2) 高収益企業への事業戦略

- ・ソリューション型研究開発企業
- ・マーケット深耕
- ・ファブレス経営
- ・M&A, アライアンス
- ・グローバル経営
- ・やりがい経営

(3) 高収益企業への仕組

オンリーワン技術

- ・製品開発と特許
- ・差別化と顧客密着
- ・プライスリーダー

依命書システム

- ・営業員への粗利依命
- ・製作チームへの粗利依命
- ・デミングサイクルの実践

モチベーションの高揚

- ・部門経営ビジョンの明示
- ・徹底討論
- ・インセンティブ

低コスト経営

- ・少数精鋭集団
- ・変化に即応
- ・事業効率の追求

<ハードディスク市場>

- 動画アプリケーション等の増加による更なる大容量HDの必要性の拡大（書込み方式は垂直からデスクリート媒体へ）
- 携帯音楽プレーヤー、携帯電話、カーナビ、ビデオレコーダー、ビデオカメラ、スチルカメラ、その他各種デジタル家電製品へのHD搭載の拡大（用途拡大が継続）
- フラッシュメモリとの競合は限定的で棲み分け

<液晶パネル市場>

- 薄型平面TV普及(液晶が主流)、40～50インチの大型化へ
- 2011年の地上波デジタル放送本格稼働までは積極的な設備投資が継続
- 50インチ以上対象にした次世代の計画へ
- 昨年より有機ELパネルが再び活況しだす

<半導体市場>

- シリコンサイクルが上昇局面へ
2008年まで継続予想
- 特にモバイルブロードバンドの普及に伴う通信系半導体の需要増が続く

<クリーニング市場>

- 安定市場。消費回復と連動したクリーニング消費拡大の兆し
- 資金力があり自動化設備投資に積極的な大手店と小規模店の二極化が進行



3-4 事業別の課題と今後の取組み

事業区分	現 状	課 題	現在・今後取組み
ハードディスク 関連事業	■ バニッシャーでは国内・ 外で約80%のシェア ■ マーケットリーダー	■ バニッシャー市場シェ アの拡大	■ バニッシャー世界シェア 100%を目指す（高スルー ット化、省スペース化）
		■ ワイピング市場シェア の拡大（垂直媒体に対 応）	■ ワイピングシェア100%を 目指す
		■ デスク、半導体・液晶 用コンベアの拡販	■ 海外も含めたコスト低減
		■ 消耗品の拡販	■ ワイピング用消耗品の拡大
液晶関連事業	■ プラズマ・ドライ・エッチン グでは市場シェア25% 程度を確保 （競合は1社のみ） ■ 第10世代機の開発スタ ート	■ 市場シェアの拡大	■ 競合製品との差別化 オンリーワン技術の確立
		■ 粗利率の向上	■ 徹底したコストダウン設計と コスト管理 ■ 協力会社との連携強化

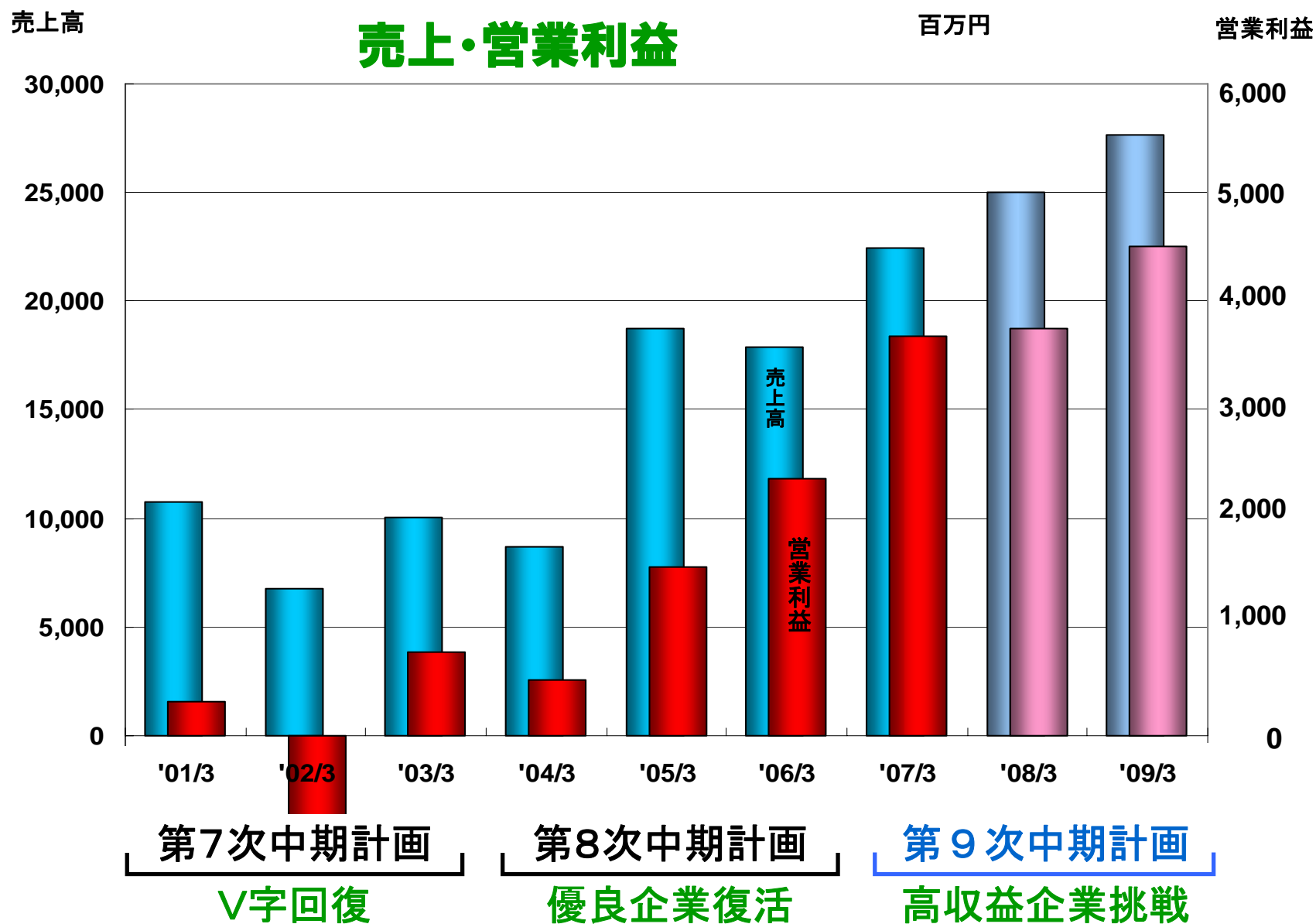


3-4 事業別の課題と今後の取組み

事業区分	現 状	課 題	現在・今後取組み
半導体 関連事業	<ul style="list-style-type: none">■市場シェア5%■特定顧客との関係は強固	<ul style="list-style-type: none">■第2、第3の特定顧客の確保■粗利率の向上	<ul style="list-style-type: none">■特定顧客確保に集中■主要製品のバージョンアップ■新製品の投入<ul style="list-style-type: none">・16個同測ハンドラー・簡易ハンドラー
クリーニング 関連事業	<ul style="list-style-type: none">■業界でのブランド力は強固■包装機国内シェア約90%■仕上機国内シェア約50%	<ul style="list-style-type: none">■シェアアップ■粗利率の向上■海外売上の拡大	<ul style="list-style-type: none">■製品のシステム販売■製販一体化によるコスト低減■米国、中国への拡大



3-5 業績推移と第9次中期計画 (連結)





業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予数値と異なる可能性があります。

ワイエイシイ株式会社